



バイリンガル組込みソフトウェアエンジニア【日系医療機器メーカー】

外資系エンジニアリングメーカーでの募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メ...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

外資系エンジニアリングメーカー

Job ID

1576475

Industry

Electronics, Semiconductor

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - Other Areas

Salary

7 million yen ~ 9 million yen

Work Hours

09:00 ~ 18:00

Holidays

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土日、夏季休暇、年末年始休暇

Refreshed

February 19th, 2026 20:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2354556】

医療機器向けバイリンガルハードウェアアーキテクトとして、シニアテクニカルリーダーの役割を担い、技術規格や各種規制を遵守しながら、診断・モニタリング用医療機器の設計・開発およびライフサイクル管理をリードします。システムエンジニアリングの高い専門性を活かし、顧客のニーズや課題を正確に把握し対話しながら、要件定義から製品化までのエンジニアリングソリューションを提供。ハードウェア・ソフトウェアの両面を統合的に管理し、オフショアの各チームと協働して顧客満足度の高い成果を目指します。提案活動にも積極的に関わり、腎臓デバイス（透析）の経験があれば活かせます。

【魅力】

長期的かつスケーラブルな新規事業にコアメンバーとして携わり、企業の成長に貢献できる機会があります。

【成長機会】

経験を積むことでシニアアーキテクトやプリンシパルアーキテクトへの昇進が可能。営業やデリバリー、事業投資に関わるリーダーシップポジションなど多様なキャリアパスもあります。

Required Skills

■必須要件■ Must Have

製品開発ワークフロー、特にハードウェア設計・開発に関する知識

回路図入力ツール（Cadence Allegro/Mentor Graphics/Zuken/Altium）の使用経験、部品選定、DC DCコンバータなどの電源部品、低電圧信号処理回路設計、トランステューサインターフェース設計、部品公差解析の経験

8/16/32ビットプロセッサベースの設計やメモリインターフェース（SDRAM、Flash）などのアーキテクチャに関する実務経験

技術文書作成スキル：ハードウェア製品の仕様書とテスト手順書の作成経験

ボードの立ち上げ、製品テスト手順、EMI/EMC適合性試験を含むテスト経験、オシロスコープ、マルチメータ、プログラマブルテスト負荷などの試験機器に関する知識

■尚可要件■ Good to Have

医療機器製品規格（IEC60601-1）、医療機器製品開発ライフサイクルプロセスおよび関連文書・製品情報管理（PIM）および製品ライフサイクル管理（PLM）ツールの知識

■語学力■ Language Skill

英語力 - ビジネスレベル（会話、読解、文書作成など）

日本語力 ネイティティブレベル / JLPT N2レベル以上（良好なコミュニケーション能力、読解力、文章力、プレゼンテーション能力必須）

Company Description

ご紹介時にご案内いたします